



【テクニカルプログラママネージャー/ディレクター候補】顧客と海外工場を繋ぐ技術営業■英語力を活かしグローバルに活躍◎

シンガポール本社・外資系OSAT企業 | 日系半導体メーカーを技術面で支える | WFH

Job Information

Hiring Company

UTAC Japan

Job ID

1561086

Division

Japan sales

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kyoto Prefecture, Kyoto-shi Shimogyo-ku

Salary

8 million yen ~ 12 million yen

Work Hours

8:30~17:15 (休憩時間1時間)

Holidays

土日祝日／夏季・年末年始休暇

Refreshed

October 9th, 2025 14:40

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 10 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

《募集要項・本ポジションの魅力》

- **業務内容:** 半導体後工程の技術窓口として顧客対応・案件管理を担当
- **やりがい:** 日本市場と海外工場をつなぐ重要な技術ポジション
- **語学/経験が活かせる:** グローバルチームとの連携で英語力・マネジメント力が活かせる
- **働く環境:** 京都勤務または在宅勤務が選択可能な働き方

【業務内容】

本ポジションは新規・既存のお客様の技術的な問い合わせの最初の窓口となり、営業チームや海外工場オペレーションチームと連携し増加する日本市場でのお客様のご要望にお応えしていく業務になります。
実務でビジネスレベルの英語力は必須です。

<具体的な業務>

- 半導体パッケージの組立プロジェクトにおいて、新規および既存顧客の販売前・販売後の技術要件を管理する
- 見込み顧客および既存顧客に対し、製品・サービスに関する技術提案を行う
- 技術的な問い合わせの一次窓口として、営業チームやオペレーションチームと連携し、顧客の要望を実現する
- 営業プロセスの一員として、新たなビジネス機会を探索し、営業および上長へ技術的な実現可能性をフィードバックする
- 設計／シミュレーションプロセスを通じて新しいパッケージ要件を立ち上げ、顧客との設計完了までをフォローする
- 設計から品質保証、生産立ち上げまで、新規デバイスの全工程を管理する
- 顧客のIC製品におけるパッケージング要件をレビュー・評価し、UTAC工場のパッケージング能力・ロードマップ・プロセスフロー・設計ルールの範囲内で最適なパッケージソリューションを提案する
- プロジェクトの技術仕様を策定し、生産立ち上げを含む品質保証プロセス全体の構築・調整を行う
- 顧客のQBR（四半期ビジネスレビュー）における技術的事項へ対応する
- 品質に関する課題について、工場と連携し顧客対応を主導する
- 製造上の技術的問題に対する顧客危機管理を担当し、低歩留まりの分析、CAR（是正処置報告書）、DOE（実験計画）対応など、顧客と工場の技術的な橋渡しを行う

【募集背景】

来年度定年退職になる社員 1 名の後任の方の採用になります。(2026 年 9 月定年退職)

【配属先】

- 部署・グループ：日本営業部
- 直属の上司の役職・職務：日本営業部長
- 直属の部下数：未定

【企業特色】

シンガポールが本社の外資系企業の日本法人営業所です。
弊社は OSAT(Out-sourced Semiconductor Assembly and Test)であり、半導体後工程の組み立てと検査を国内の半導体メーカーのお客様から請け負い、海外4か国にあるグループ工場でおこなっています。
お客様は日本の半導体メーカーになり、弊社は日本の市場をターゲットに営業を行っております。

【雇用形態】

正社員

【給与】

経験考慮の上、応相談

【就業時間】

会社の規定に準ずる

【勤務地】

京都 または 在宅勤務
住所:京都府京都市下京区 中堂寺栗田町93京都リサーチパーク6号館422号
※出張有

【休日休暇】

会社の規定に準ずる

【待遇・福利厚生】

会社の規定に準ずる

■選考プロセス

- ・面接：計 2～3 回
- ・適性テスト：無

Required Skills**【応募要件】****■必須要件**

- アドバンストパッケージの業務経験
- FOL (front-of-line)および EOL (end-of-line)の組立作業に関する十分な知識
- SPC および DOE に精通している
- 日本語と英語での会話、読み書き、対人コミュニケーション、プレゼンテーションのスキルがあること。
- 他人と協力して業務を遂行し積極的に自らの仕事に取り組めること。
- チームリーダー、プロジェクトマネジメントの経験を有し、国籍など関係なくグローバルな環境、クロスファンク

シヨナルなチームワークに慣れていること。

■歓迎要件

- 工学系学位、IC 組立関連または半導体業界での 10 年以上の実務経験があることが望ましい
- テストエンジニアリング経験者優遇

Company Description